



# KOLLOQUIUM

Institut für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

## **Passive Komponenten für Mobilfunkendgeräte**

**Dr.-Ing. Stefan Seitz**

EPCOS AG, München

**Donnerstag, der 08.02.2007, 17<sup>15</sup> Uhr**  
Cauerstraße 7/9, Hörsaal H5

**Diskussionsleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Weigel**

Der äußerst dynamische Markt mobiler Kommunikation mit einer Stückzahl von 1 Milliarde neu produzierter Telefone im Jahr 2006 und einer Durchdringung von bereits mehr als 40% der Weltbevölkerung erfordert höchste Anstrengungen auf den Gebieten Materialforschung, Komponentenentwicklung, Integrationstechnologien, Systemdesignmethoden und Softwaretechnologien, um Herausforderungen wie drastische Miniaturisierung bei gleichzeitiger Erhöhung von Funktionalität und Leistungsfähigkeit unter höchstem Kostendruck gewachsen zu sein. Im analogen Frontend des Mobiltelefons, dem Radio werden verschiedenste aktive und passive Komponenten (Si, GaAs, SOS, SAW, BAW, SMD...) bis hin zu hochintegrierten Modulen (SiP, LTCC, SMT, Wirebond, Molding, ...) eingesetzt. Nur mit heterogenen Technologien kombiniert mit innovativen Lösungsansätzen können die oben genannten Herausforderungen erfüllt werden. In diesem Vortrag wird auf passive Bauelemente, RF-Module, Integrationstechnologien und Roadmaps für Mobilfunkgeräte eingegangen. Anschließend wird über Stand und Aktivitäten der Arbeitsgruppe „Technologien für Information und Kommunikation“ der „European Technology Plattform of Smart Systems Integration“ berichtet.